

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2022 年 6 月 13 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于成都士兰投资建设项目的议案》

为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产 720 万块汽车级功率模块封装项目”。该项目总投资为 30 亿元，资金来源为企业自筹。项目建设周期为 3 年。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案具体内容及相关独立意见详见《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：临 2022-037。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-038。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日